

**HDC-C-HE-SM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1.5, gedreht, Kupferlegierung
Best.-Nr.	<a href="#">1200700000</a>
Art	HDC-C-HE-SM1.5AG
GTIN (EAN)	4008190074920
VPE	100 ST

**HDC-C-HE-SM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

**Abmessungen und Gewichte**

Durchmesser	4.5 mm	Nettogewicht	1.31 g
-------------	--------	--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Allgemeine Angaben**

Kontaktdurchmesser Stift Ø	2.5 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	7.5 mm
Anschlussart	Crimpanschluss	Ausführung Einsatz	HE, HEE, HQ, MixMate
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Silber
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Stift
Werkstoff	Kupferlegierung	Baureihe	HE
Herstellungsverfahren	gedreht	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Werkstoff des Kontaktes	Kupferlegierung		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-HE-SM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**